

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2026-002

陕西源杰半导体科技股份有限公司

关于公司拟投资建设光电通讯半导体芯片和器件研 发生产基地二期项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目
- **投资金额：**项目投资总额约为 12.51 亿元人民币（以实际投入为准）。
- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次对外投资事项已经陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议、第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第二届董事会第二十六次会议审议通过。本次投资事项已达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。

● 相关风险提示：

（一）本项目的资金来源为公司自有资金及自筹资金，若资金筹措不及预期，可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。同时，项目实施过程中可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高。

（二）本次投资建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。但项目建设及达产需要一定的周期，仍可能面临宏观经济波动、行业政策、市场环境变化等不确定因素带来的风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司战略规划，为把握市场机遇，提升规模化生产能力并增强行业竞争力，公司拟投资建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目，投资总额约为 12.51 亿元人民币（以实际投入为准）。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：约为 12.51 亿元人民币（以实际投入为准） <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

公司于 2026 年 2 月 9 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司拟投资建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目的议案》，同时董事会授权公司董事长及其授权人士办理本次投资相关的具体事宜。本次投资事项已达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资事项不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次拟投资建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目。

（二）投资标的的信息

1、项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目
项目主要内容	新建光芯片生产线及生产厂房、配套设施
建设地点	陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号
项目总投资金额	约为 12.51 亿元人民币（以实际投入为准）
上市公司投资金额	约为 12.51 亿元人民币（以实际投入为准）
项目建设期（月）	18
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

2、各主要投资方出资情况

本投资项目不涉及其他投资方，公司为唯一投资方及项目实施主体，拟以自有资金或自筹资金建设投资项目，投资总额约为 12.51 亿元人民币（以实际投入为准）。

3、项目目前进展情况

本次投资项目当前处于前期筹备阶段。

4、项目市场定位及可行性分析

项目聚焦高速光芯片领域，把握数据中心市场发展的机遇，契合数字经济发展对光通信核心器件的需求。依托公司 IDM 流程自主可控技术积淀及现有客户基

础，旨在通过产能扩充与工艺优化，持续响应市场需求变化，提升公司在全球光芯片领域的市场份额与综合竞争力。

从经营发展角度看，实施本项目能够进一步提升生产效率和产品稳定性，形成稳定的高端光芯片规模化供应能力，以满足国内外客户持续增长的产品需求，这不仅有助于巩固公司在现有市场的竞争优势，也为把握行业技术升级带来的市场机遇创造了有利条件。同时，通过产能提升与工艺优化，增强公司的整体盈利能力与抗风险能力，为可持续发展奠定更坚实的基础。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金及自筹资金，不属于募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资项目的实施，旨在通过优化产能布局与生产工艺，提升公司在高端光芯片领域的综合供应能力。项目建成后，将有助于公司把握市场增长机遇，满足客户在数据中心建设等领域持续提升的产品需求，增强订单交付的稳定性与响应速度。公司将加强资金管理，合理规划资金安排，分阶段推进项目实施，不会影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的经营成果及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

（一）本项目的资金来源为公司自有资金及自筹资金，若资金筹措不及预期，可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。同时，项目实施过程中可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高。

（二）本次投资新建光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。但项目建设及达产需要一定的周期，仍可能面临宏观经济波动、行业政策、市场环境变化等不确定因素带来的风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日